Soldeerdraad Sn99Ag0,3Cu0,7, 0,75 mm, C3+, loodvrij, 500 g



Deze soldeerdraad van Tamura Elsold is ontwikkeld voor professionele toepassingen in de elektronica-productie, de servicebranche en voor veeleisende reparatiesoldeerwerkzaamheden. De loodvrije legering Sn99Ag0,3Cu0,7 (SAC0307) biedt een uitstekende soldeerbaarheid, hoge betrouwbaarheid en stabiele elektrische verbindingen. Dankzij de diameter van 0,75 mm is de soldeerdraad bijzonder geschikt voor nauwkeurig handsoldeerwerk en fijne elektronische assemblages.

Het halogeenvrije vloeimiddel C3+ zorgt voor een optimale bevochtiging van de soldeerpunten en draagt bij aan schone, reproduceerbare soldeerresultaten. De fluxresten zijn ontworpen als ‘no-clean’-resten, waardoor extra reinigingswerk vaak overbodig is. De microgelegeerde MA-S-technologie verhoogt bovendien de oxidatiebestendigheid en verbetert de proceszekerheid bij langdurige soldeerwerkzaamheden.

- Legering: Sn99Ag0,3Cu0,7 (SAC0307)
- Draaddiameter: 0,75 mm
- Type vloeimiddel: C3+

- Vloeimiddelgehalte: 3,5 %
- Vloeimiddelklasse: ROL0 / F-SW32 / 1.1.3
- Halogeenvrij vloeimiddel
- Loodvrije uitvoering
- Microlegering MA-S voor verhoogde oxidatiebestendigheid
- Spoelgewicht: 500 g

Artikelnr.	**WL93259**
Model	Flussmitteltyp C3+ (bleifrei)
Fabrikant	TAMURA ELSOLD
Fabrikant artikelnr.	RÖLOT6138
GPSR-fabrikantgegevens	TAMURA DEUTSCHLAND GmbH Hüttenstraße 1 DE-38871 Ilsenburg www.tamura-elsold.de
Verkoopeenheid	1 rollen
Inhoudseenheid	1 Rollen
Gedetailleerde inhoudseenheid	500 g
Fluxklasse	1.1.3, F-SW32, ROL0
Legering	Sn99Ag0,3Cu0,7
Vloeistoftype	C3+
Fluxinhoud	3,5 %
Classificatie	• ROL0 • 1.1.3 • F-SW32
Draaddiameter	0,75 mm
Legering	Sn99Ag0,3Cu0,7
Loodvrij/loodhoudend	ongelood
ESD-compatibel	nee